LAGENAUFBAU HDI (Standard)

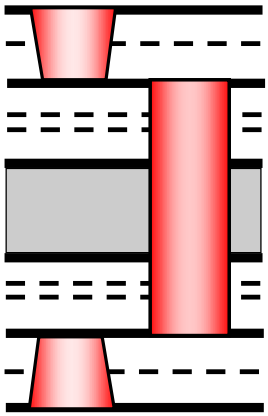
HDI06_1+4b+1_0,80_35

6 - Lagen

Kern: 0,25 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.:	**1 + 4B + 1**
KUNDE:	

WÜRTH ELEKTRONIK



LAGENBEZEICHNUNG KUNDE	LAGENBEZEICHNUNG WE	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE [µm]	KUNDEN-FORDERUNG [µm]
1	TOP/VS	Folie	12 µm	1)	12	
				1 x 1080	**60**	
2	VSK1	Folie	12 µm		**35**	
				2 x 1080	**132**	
3	2		35 µm		**33**	
		0,250 mm			**250**	
4	3		35 µm		**33**	
				2 x 1080	**132**	
5	RSK1	Folie	12 µm		**35**	
				1 x 1080	**60**	
6	BOT/RS	Folie	12 µm	1)	12	

1) Endkupferdicke Außenlagen ca. 50 µm

Gesamtdicke Material:				794	

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

							Datum:	Bearbeiter:
MATERIALDICKE:	**0,80**	+/-	0,08	mm				
DICKE über galv. Endoberfläche	0,88	+/-	0,11	mm				
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	0,94	+/-	0,13	mm				
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:			

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision		
05.01.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	05.01.2006	R. Schönholz	00	Seite:	16+